

JPCAショー2018へ出展いたします

出展概要 Information about the exhibition

▶ **会期：2018年6月6日(水) - 8日(金)、10:00~17:00**

> Dates and time: June 6(Wed) to 8 (Fri), 2018; 10:00 to 17:00

▶ **会場：東京ビッグサイト**

> Venue: Tokyo Big Sight, Tokyo, JAPAN

▶ **小間番号：東7ホール 7B-09**

> Booth Number: East hall 7, 7B-09

NPIプレゼンテーション

■ 日時：6月7日(木)11:30~12:00

■ 会場：東7ホール NPIプレゼンテーション会場(入場無料)

■ タイトル：ファインパターン対応Niフリー新規無電解Au/Pd/Au工程の紹介

JPCA Show AWARDS 2018を受賞いたしました



上村工業株式会社



東7ホール

ウエムラブース内プレゼンテーションのご案内

弊社の研究所員が、プレゼンテーションを行います。

6月6日(水) 11:00 14:00 15:00 16:00

テーマ：フレキシブル基板対応の無電解Ni/Auプロセス

ニムデン® NPG-4、ゴブライト® TLM-44、ナノシーラー MSL-17

6月7日(木) 11:00① 14:00② 15:00① 16:00②

6月8日(金) 11:00② 14:00① 15:00② 16:00①

テーマ：①微細パターンビアフィル用硫酸銅めっき添加剤

&スルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤

スルカップ® EFL-02、スルカップ® EVF-YF3

テーマ：②ファインパターン対応無電解Au/Pd/Auプロセス (IGEPIG)

次世代高密度回路技術をサポートするめっき薬品

電子機器の小型化・高機能化により銅回路の更なる高密度化および高速化が期待されています。このようなプリント配線板の銅回路形成では「ロープロファイル絶縁樹脂への高密着性を実現したデスマプロセス」や「ファインパターン形成に適した薄く均一な下地無電解銅めっきプロセス」、「穴埋め性および膜厚分布の均一性に優れたビアフィル電気銅めっき」等が求められています。ファインパターン銅回路形成に対するこれらの技術を提案いたします。

セミアディティブ工法感光性樹脂対応デスマ/無電解銅前処理プロセス

アップデス® プロセス & アルカップ® プロセス

ファインパターン SAP 対応無電解銅めっき浴 スルカップ® PEAV5

BVH 内めっき付き回り性向上無電解銅めっき浴 スルカップ® PTU

微細パターンビアフィル用硫酸銅めっき添加剤 スルカップ® EFL-02

ブース内プレゼン

スルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤 スルカップ® EVF-YF3

ブース内プレゼン

FO-PLP 銅ポスト用硫酸銅めっき添加剤 スルカップ® EST-01

新方式垂直連続搬送めっき装置 U-VCPS

高速電気めっき装置 スピードプレーター

フレキシ基板への高い信頼性をサポートするめっき薬品

電子機器の薄膜化や軽量化によりフレキシブル基板およびリジットフレックス基板においても、銅回路の更なる高密度化と高速化に伴い高レベルの銅銅間接続信頼性が求められます。積層銅箔および内層銅上に導電性皮膜を形成せず、導電性銅合金薄膜を樹脂にのみ形成することにより直接硫酸銅めっきを行なうプロセスを提案いたします。また、FPC向けに耐折り曲げ性に優れた「高耐食性無電解めっき浴」を提案いたします。

ダイレクトめっきプロセス

パラダイム® プロセス

フレキシブル基板対応無電解 Ni/Au プロセス

ニムデン® NPG-4、ゴブライト® TLM-44、
ナノシーラー MSL-17

ブース内プレゼン

プレゼンテーションのご案内

▶ブース内プレゼンテーション

弊社の研究所員が、プレゼンテーションを行います。
質問等も可能ですので、ぜひお立ち寄りください。
※詳細はホームページをご覧ください。

▶NPIプレゼンテーション (出展社製品技術セミナー)

NPIプレゼンテーションに参加いたします。
予約の必要はございません。お気軽にお立ち寄りください。

■日時：6月7日(木) 11:30~12:00

■会場：東7ホール NPIプレゼンテーション会場(入場無料)

■タイトル：ファインパターン対応Niフリー
新規無電解Au/Pd/Au工程の紹介

■問い合わせ先：cpd@uyemura.co.jp

ぜひお立ち寄りください。



こちら以外にも各種資料をご用意しております。
今回の展示にない製品につきましてもお気軽に声をおかけください。
スタッフ一同、皆さまのご来場をお待ちいたしております。

多様化する実装技術をサポートするめっき薬品

電子部品における「良好な接合信頼性」を維持できる最終表面処理が必要とされてきました。近年、電子機器の小型化に対応し、接合部分の微細化が急激に進んでいます。これらの背景を踏まえて、「微細配線パターンに対応できる無電解めっき浴」、「新規接合方式に対応できる無電解めっき浴」、「微小パッドや微小チップに対応できる電気すずめっき浴」、「次世代接合材向けめっき浴」等、様々な基材に対応できる前処理薬液も含めて提案いたします。

フリップチップバンプ用すずめっきプロセス

エルスタナー GLK-03 (conformal bath)
エルスタナー GKH-22 (filling bath)

シアンフリー無電解金めっき浴

ゴブライト® TNC-25 / TNC-45

シアンフリー電気銀めっきプロセス

サブレア® GPS プロセス

チップ部品へのニッケル/中性すずめっきプロセス

ニッケル：サブレア® ニッケル AEP-1
すず：ティナデス® GAM-1

ファインパターン向け前処理プロセス

無電解 Ni/Pd/Au プロセス(ENEPIG)用 パラジウムめっき浴

Pd-P 皮膜：アルタレア® TPD-35
純 Pd 皮膜：アルタレア® TPD-21

ファインパターン対応無電解 Au/Pd/Au プロセス(IGEPIG)

ブース内プレゼン

NPIプレゼンテーション 6月7日(木) 11:30~12:00

電気金めっき浴自動液管理装置 ケミロボ® 3-EAU

